

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明

中国证券监督管理委员会：

根据贵会 161762 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“公司”、“申请人”或“发行人”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）及相关中介机构对反馈意见逐项进行了认真研究、落实，分别对有关问题进行了书面说明、解释和核查，并对申请文件进行了修订，现将落实反馈意见的有关情况说明如下，请予审核。

1、如无特别说明，本反馈意见回复中的简称或名词释义与非公开发行股票预案中的相同。

2、本反馈意见回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、重点问题

1、2015 年末，申请人货币资金余额 23,328.71 万元，其他流动资产中银行理财产品余额 37,097.26 万元。申请人拟投资 111,198.68 万元建设新能源汽车及物联网用线路板项目，拟全部用本次募集资金投入。

请申请人：（1）结合目前的货币资金余额情况、资产负债率水平、银行授信情况及委托理财情况，说明本次募投项目使用股权融资的必要性和合理性，本次融资规模与公司现有资产、业务规模等是否匹配；（2）说明上述募投项目的投资构成明细、测算依据和测算过程，说明是否使用募集资金安排非资本性支出及其合理性；（3）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排；（4）说明前述募投项目效益测算过程及谨慎性；（5）说明本次募投项目产品与公司现有产品、首发募投项目高端精密线路板扩产项目产品的异同，包括但不限于产品用途、生产工艺、技术、原材料、客户等。请保荐机构核查并发表意见。

【回复】

问题（1）结合目前的货币资金余额情况、资产负债率水平、银行授信情况及委托理财情况，说明本次募投项目使用股权融资的必要性和合理性，本次融资规模与公司现有资产、业务规模等是否匹配；

一、结合目前的货币资金余额情况、资产负债率水平、银行授信情况及委托理财情况，说明本次募投项目使用股权融资的必要性和合理性

（一）公司自有资金大部分已有明确用途

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人的货币资金余额为 38,027.84 万元，银行理财产品余额为 20,798.66 万元，合计 58,826.50 万元，扣除 IPO 剩余募集资金 11,865.10 万元，发行人可支配货币资金为 46,961.40 万元。

同时，发行人的短期借款金额为 9,504.96 万元，前次募投项目尚需以自筹资金投入的金额为 22,604.00 万元，扣除上述 2 项支出，仅剩余 14,852.44 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的应付票据和应付账款余额为 66,429.38 万元，应收票据和应收账款余额为 62,754.52 万元，公司应付应收的资金缺口达到 3,674.86 万元，若应收应付的期限不匹配，发行人需预留更多货币资金。

发行人的业务规模快速发展，日常生产经营对流动资金的需求较大，同时为适应市场需求的发展，保持行业竞争优势，提升市场份额，必须扩大现有产能，

改善产品结构，公司目前的自有资金无法满足本次募投项目的资金需求。

（二）外部借款主要为短期借款，不适宜用于长期项目建设

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的借款全部为短期借款，短期借款金额为 9,504.96 万元，公司尚未使用的银行授信额度约为 69,042.35 万元，具体情况如下：

单位：万元

授信银行	授信额度	授信期间	已使用额度	尚未使用授信额度
兴业银行惠州支行	20,000.00	2015.08.17 -2016.08.17	-	20,000.00
招商银行惠州分行	45,000.00	2015.07.20 -2017.07.20	19,621.53	25,378.47
民生银行惠州分行	20,000.00	2016.6.21 -2017.6.20	1,736.12	18,263.88
花旗银行深圳分行	9,600.00	2016.02.06 -2019.07.25	4,200.00	5,400.00
合计	94,600.00	-	25,557.65	69,042.35

注 1：银行授信额度含借款、银行承兑汇票、信用证等；

注 2：花旗银行深圳分行授信额度为等值人民币 8,190 万元以及等值美元 200 万元之和，按人民币 9,600 万元计算。

公司尚未使用的银行授信额度为 69,042.35 万元，均为短期借款授信，若公司以短期借款进行融资，并投入长期建设项目，资金周转成本较高，融资风险较大，难以满足本次募集资金投资项目的资金需求。

（三）公司资产负债率高于行业平均水平，债务融资不利于公司健康发展

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 21.74 亿元，负债总额为 8.83 亿元，资产负债率达到 40.63%。根据 Wind 数据库中证监会行业分类，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，该行业共有 253 家上市公司，其中 2015 年度印制线路板销售收入占比超过 50%的公司为 10 家（包括本公司），将上述印制线路板销售收入占比超过 50%的公司认定为同行业可比上市公司，下同。

截至 2016 年 6 月 30 日，同行业可比上市公司的平均资产负债率为 34.20%，具体情况如下：

公司名称	资产负债率（%）
超声电子	27.45
超华科技	31.99

沪电股份	41.48
依顿电子	17.59
天津普林	26.67
中京电子	41.98
丹邦科技	29.91
兴森科技	41.18
博敏电子	49.58
平均值	34.20
胜宏科技	40.63

注：同行业可比上市公司的数据来源于 Wind 数据库，下同。

由上表可知，公司 2016 年 6 月 30 日的资产负债率为 40.63%，高于同行业可比上市公司的平均水平。本次募集资金投资项目的总投资金额为 111,198.68 万元，若全部采用债务融资，公司的资产负债率将由 40.63% 上升至 60.72%，将远高于行业平均水平，同时债务融资将增加公司未来的资金成本和财务风险，不利于公司健康发展及未来战略的实施。

（四）新能源汽车及物联网用线路板项目实施周期较长，股权融资符合资金期限结构要求，是现阶段适合公司未来发展状况的融资方式

股权融资具有较好的规划及协调性，有利于公司实现长期发展战略。新能源汽车及物联网用线路板项目建设周期为 1.5 年，投资回收期（税后）为 6.78 年，因此，该项目对资金的使用具有长期性，为长期资金需求，需要长期筹资以配合长期资产的投入。公司筹集长期银行借款的能力较弱，需采用股权融资以配合长期资产的投入，以降低偿债风险，缓解项目效益释放前的短期偿债压力。

（五）公司需要保持一定的债务融资能力以拓展公司各项业务

基于公司战略考虑，除了本次新能源汽车及物联网用线路板项目外，公司未来仍将大力发展现有高端高精密线路板业务，需要保持一定的债务融资能力。

综上所述，本次募投项目采用股权融资，一方面可以降低公司的资产负债率，优化公司的资本结构，避免投资不能在短时间内全部收回所造成的偿付压力，使公司稳定、健康发展；另一方面可以提升公司的资金实力，提高抗风险能力，减少债务融资的利息支出，有利于公司经营业绩的提升和发展战略的实施。

因此，本次募投项目使用股权融资是必要、合理的。

二、本次融资规模与公司现有资产、业务规模等是否匹配

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的总资产、净资产分别为 217,429.30 万元、129,092.05 万元。公司 2015 年的营业收入为 128,463.15 万元，同比增长 18.21%；2016 年 1-6 月，公司的营业收入为 78,957.47 万元，同比增长 38.33%，公司业务规模保持快速增长。本次融资规模与公司总资产、净资产及营业收入的比值情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	本次融资规模	占比
总资产	217,429.30	108,152.42	49.74%
净资产	129,092.05		83.78%
项目	2015 年度		-
营业收入	128,463.15		84.19%

由上表可知，本次融资规模与公司总资产的比值低于 50%，与净资产及营业收入的比值均低于 85%。同时，公司的资产、业务规模保持快速增长。

因此，本次融资规模与公司的资产和经营规模相匹配。

三、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了本次非公开发行 A 股股票预案、募投项目的可行性研究报告、2015 年及 2016 年 1-6 月财务报告、银行授信合同、贷款合同、委托理财合同及同行业上市公司资料等，并访谈了发行人高管，了解本次募投项目的具体内容及资金投入情况，分析本次股权融资合理性、必要性，以及与现有资产、业务规模的匹配性。

经核查，保荐机构认为：

发行人本次募投项目使用股权融资是必要、合理的；募集资金的规模与公司的资产和经营规模匹配，符合公司未来发展战略。

问题（2）说明上述募投项目的投资构成明细、测算依据和测算过程，说明是否使用募集资金安排非资本性支出及其合理性；

一、说明上述募投项目的投资构成明细、测算依据和测算过程

（一）募投项目的投资构成及募集资金使用情况

本次募投项目的投资总额为 111,198.68 万元，拟投入的资金主要用于建筑工程、基建投入、装修投入、设备购置、设备安装等建设投资及铺底流动资金，公司第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票

方案的议案》，公司拟投入募集资金的金额为 108,152.42 万元，具体情况如下：

序号	项目	投资金额 (万元)	占投资总额比例	拟投入募集资金金额(万元)
1	建设投资	94,152.42	84.67%	94,152.42
1.1	建筑工程	18,720.00	16.83%	18,720.00
1.1.1	基建投入	11,232.00	10.10%	11,232.00
1.1.2	装修投入	7,488.00	6.73%	7,488.00
1.2	设备购置费	71,840.40	64.61%	71,840.40
1.3	设备安装费	3,592.02	3.23%	3,592.02
2	铺底流动资金	17,046.26	15.33%	14,000.00
合计		111,198.68	100.00%	108,152.42

(二) 测算依据及测算过程

1、建筑工程费

本次募投项目选址位于广东省惠州市淡水镇新桥村行诚科技园，新增车间、仓库、办公的建筑面积共 62,400 平方米，根据选址所在地建筑工程和装修的市场价格测算，基础建设的均价为 1,400 元/平方米，装修的均价为 1,600 元/平方米，合计为 18,720.00 万元，具体测算如下：

项目	建筑面积 (m²)	基建均价 (元/m²)	装修均价 (元/m²)	投资额 (万元)
建筑工程	62,400.00	1,400.00	1,600.00	18,720.00

截至 2015 年 12 月 31 日，公司房屋建筑物的原值为 19,713.30 万元，公司及子公司胜华电子拥有及租赁的生产、办公房产的面积为 70,931.61 平方米，2015 年的营业收入为 128,463.15 万元；本次募投项目建筑工程的建筑面积为 62,400.00 平方米，预计投入 18,720.00 万元，项目达产后每年实现营业收入 156,000.00 万元。综上，本次募投项目的建筑工程投入金额是合理的。

2、设备购置费

本次募投项目所需的设备数量根据项目产能进行测算，设备价格根据市场价格进行测算，设备购置费为 71,840.40 万元，具体情况如下：

序号	设备名称	数量 (台、套)	单价 (万元/台、万元/套)	总价 (万元)
1	全自动开料机	3	40.00	120.00
2	自动磨边机	3	21.00	63.00
3	烤箱	4	3.60	14.40

5	内层前处理	4	39.00	156.00
6	内层涂布机	4	156.00	624.00
7	自动曝光机	10	133.00	1,330.00
8	DES	3	146.00	438.00
10	AOI	3	110.00	330.00
11	VRS	12	8.50	102.00
13	棕化线	5	70.00	350.00
14	热熔机	10	150.00	1,500.00
15	回流线	4	100.00	400.00
16	pp 裁切	8	30.00	240.00
17	钢板及承载盘	3	300.00	900.00
18	压机	20	300.00	6,000.00
19	裁磨线	5	160.00	800.00
21	钻孔机	120	80.00	9,600.00
22	激光钻孔	30	280.00	8,400.00
23	孔位检查机	3	45.00	135.00
25	水平 PTH	7	270.00	1,890.00
26	填孔电镀	12	270.00	3,240.00
27	VCP	19	270.00	5,130.00
29	前处理	7	56.00	392.00
30	压膜机	14	80.00	1,120.00
31	LDI 曝光	14	520.00	7,280.00
32	DES	7	162.00	1,134.00
34	AOI 扫描	7	110.00	770.00
35	VRS 检修	28	8.50	238.00
37	前处理	3	100.00	300.00
38	塞孔机	11	10.00	110.00
39	自动印刷机	7	100.00	700.00
40	预烤隧道炉	3	38.00	114.00
41	显影线	3	165.00	495.00
42	全自动曝光机	12	265.00	3,180.00
44	自动印刷机	3	95.00	285.00
45	隧道烤箱	3	50.00	150.00

47	成型机	45	49.00	2,205.00
48	V-CUT	6	22.50	135.00
49	清洗机	4	27.00	108.00
51	自动测试机	24	65.00	1,560.00
52	飞针机	6	29.00	174.00
54	AVI	20	45.00	900.00
55	清洗	3	27.00	81.00
56	验孔机	6	24.50	147.00
57	板弯翘检查机	6	25.00	150.00
58	板弯翘整平机	5	70.00	350.00
59	周边配套	1	3,000.00	3,000.00
60	自动化设备	1	2,000.00	2,000.00
61	环保设备	1	3,000.00	3,000.00
合计		542	-	71,840.40

本次募投项目投入的设备金额较大，主要原因系本次募投项目的产品为高端高精密线路板，主要用于新能源汽车及物联网设备，产品技术含量高，对设备的精密度要求高，部分机器设备价格较高，以及该项目拟提升生产的自动化水平，降低人力成本，机器设备的自动化水平高。

本次募投项目营业收入与设备的比值与公司2015年的上述比值的比较情况如下：

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	本次募投项目
年营业收入（万元）	128,463.15	156,000.00
固定资产原值（万元）	59,372.43	71,840.40
年营业收入/固定资产原值	2.16	2.17

由上表可知，本次募投项目营业收入与设备的比值与公司2015年的上述比值接近，本次募投项目设备的投入金额合理。

3、设备安装费

项目的设备安装费按照设备购置费的 5% 计算，即 $71,840.40 \times 5\% = 3,592.02$ 万元。

4、铺底流动资金

根据项目未来期间预测收入除以平均周转率指标（公司 2014 年、2015 年的平均值）测算，本次募投项目所需流动资金为 57,141.88 万元，其中，拟投入的

铺底流动资金总额为 17,046.26 万元，本次募集资金中拟投入铺底流动资金的金额为 14,000.00 万元，未超过本募投项目所需流动资金的 30%，具体测算情况如下：

单位：万元

项目	周转率	T2 年	T3 年	T4 年	..	T12 年
销售收入		54,600.00	124,800.00	156,000.00		156,000.00
流动资产		33,487.77	76,543.48	95,679.35		95,679.35
货币资金	6.14	8,895.65	20,332.92	25,416.14		25,416.14
应收账款	2.96	18,473.60	42,225.38	52,781.72		52,781.72
预付账款	385.69	101.93	232.97	291.22		291.22
其他应收款	73.15	746.46	1,706.19	2,132.74		2,132.74
存货	7.46	5,270.13	12,046.02	15,057.53		15,057.53
流动负债		13,488.11	30,829.98	38,537.47		38,537.47
应付账款	2.92	13,461.29	30,768.66	38,460.83		38,460.83
预收账款	2,035.35	26.83	61.32	76.65		76.65
流动资金占用		19,999.66	45,713.51	57,141.88		57,141.88
流动资金本期增加额		19,999.66	25,713.85	11,428.37		-

注：T1 年表示建设期第一年，T2 年下半年开始运营。

二、说明是否使用募投资金安排非资本性支出及其合理性

本次募投项目涉及的非资本性支出为拟投入的铺底流动资金 14,000.00 万元，占募集资金的 12.94%。根据测算，公司未来三年需补充的流动资金为 15,894.50 万元，具体测算如下：

（一）测算方法及依据

假设预测期间内公司主营业务、经营模式及各项指标保持稳定，流动资产与流动负债与营业收入保持稳定的比例关系，用销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关流动资产和流动负债的变化，进而测算未来 3 年（2016 年~2018 年）公司流动资金缺口。

经营性流动资产（应收票据、应收账款、预付款项和存货）和经营性流动负债（应付票据、应付账款和预收款项）占营业收入的比值取自 2015 年末的数据，其中，应付账款及应付票据扣除了长期资产性质的款项（包括应付工程款、应付无形资产款项及应付设备款等）。

公司 2013 年至 2015 年的营业收入同比增长率分别为 2.72%、10.88%和 18.21%，2016 年 1-6 月的营业收入同比增长 38.33%，呈现快速增长趋势。公司预计营业收入未来三年内仍将保持较快增长，公司未来三年所需补充的流动资金测算按 18.21%的营业收入增长率进行，主要原因系：（1）电子信息产品更新换代加快，下游行业智能手机、平板电脑、新能源汽车、物联网和智能硬件产品的市场需求旺盛，有助于促进印制线路板行业的需求；（2）公司在原有优质客户富士康、戴尔、兆赫电子、德赛西威等优质客户的基础上，进一步引进了沃特玛、利亚德、乐视等大量优质客户，订单需求旺盛；（3）公司不断调整产品结构，重点开发应用于新能源汽车、高端显卡、LED、物联网、工业控制等产品，上述产品的技术含量高，市场需求旺盛。

（二）具体测算过程

公司对未来三年流动资金需求情况测算如下：

单位：万元

项目	2015 年	占收入比例	2016 年(E)	2017 年(E)	2018 年(E)
营业收入	128,463.15	100.00%	151,856.29	179,509.32	212,197.97
应收票据	4,959.74	3.86%	5,862.91	6,930.54	8,192.60
应收账款	48,719.26	37.92%	57,591.04	68,078.37	80,475.44
预付款项	241.70	0.19%	285.71	337.74	399.24
存货	13,608.80	10.59%	16,086.96	19,016.40	22,479.28
经营性资产小计	67,529.50	52.57%	79,826.62	94,363.05	111,546.56
应付票据（扣除长期资产性质款项*）	13,714.26	10.68%	16,211.63	19,163.76	22,653.49
应付账款（扣除长期资产性质款项*）	29,376.84	22.87%	34,726.36	41,050.03	48,525.24
预收款项	53.59	0.04%	63.35	74.88	88.52
经营性负债小计 （扣除长期资产性质款项*）	43,144.69	33.59%	51,001.34	60,288.67	71,267.25
流动资金占用 （扣除长期资产性质款项*）	24,384.81	18.98%	28,825.28	34,074.38	40,279.31
2016 年~2018 年所需流动资金=2018 年末流动资金占用金额-2015 年末流动资金占用金额 =40,279.31 万元-24,384.81 万元=15,894.50 万元					

注：*长期资产性质款项包括应付工程款、应付无形资产款项及应付设备款等。

本次募集资金中拟投入铺底流动资金的金额为 14,000.00 万元，未超过公司未来三年流动资金需求缺口。因此，本次募集资金的非资本性支出安排合理。

三、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了本次非公开发行 A 股股票预案、募投项目的可行性研究报告、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月的财务报告，与本次非公开项目相关的董事会及股东会文件等，并访谈了发行人高管，了解募投项目的建设内容、投资构成、测算情况及印制线路板行业、公司的发展情况，分析本次募集资金非资本性支出的合理性。

经核查，保荐机构认为：

（1）发行人本次募投项目的规模、投资构成、测算过程及依据合理，与公司的业务、资产规模及经营规模相匹配；

（2）本次募投项目涉及的非资本性支出主要用于投入铺底流动资金，未超过经测算的发行人未来三年需补充的流动资金，具有合理性。

问题（3）说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排；

一、本次募投项目的募集资金使用

本次募投项目新能源汽车及物联网用线路板项目的投资金额为 111,198.68 万元，拟投入募集资金不超过 108,152.42 万元，具体投入情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	建设投资	94,152.42	94,152.42
1.1	建筑工程	18,720.00	18,720.00
1.1.1	基建投入	11,232.00	11,232.00
1.1.2	装修投入	7,488.00	7,488.00
1.2	设备购置费	71,840.40	71,840.40
1.3	设备安装费	3,592.02	3,592.02
2	铺底流动资金	17,046.26	14,000.00
合计		111,198.68	108,152.42

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、募投项目建设的进度安排

本项目的建设期为 1.5 年（18 个月）。

项目的装修施工与设备安装必须按照国家的专业技术规范和标准执行，项目建设进度安排如下：

进度阶段	2个月	4个月	6个月	8个月	10个月	12个月	14个月	16个月	18个月
清理场地									
工程招标									
厂房及公用工程建设									
装修工程									
设备采购及安装调试									
人员招聘及培训									
验收竣工									

本次募投项目的投资进度如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）		
		建设期第1年	建设期第2年	合计
1	建设投资	41,349.73	52,802.69	94,152.42
1.1	建筑工程	18,720.00	-	18,720.00
1.1.1	基建投入	11,232.00		11,232.00
1.1.2	装修投入	7,488.00		7,488.00
1.2	设备购置费	21,552.12	50,288.28	71,840.40
1.3	设备安装费	1,077.61	2,514.41	3,592.02
2	铺底流动资金		17,046.26	17,046.26
	项目总投资	41,349.73	69,848.95	111,198.68

三、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了本次非公开发行 A 股股票预案、募投项目的可行性研究报告、与本次非公开项目相关会议的决议文件，并访谈了发行人高管，了解本次募投项目的投资进度及募集资金的使用计划。

经核查，保荐机构认为：

本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排合理。

问题（4）说明前述募投项目效益测算过程及谨慎性；

一、效益测算的过程及谨慎性

本次募投项目的建设期 1.5 年，运营期按 10.5 年进行效益测算，测算的总体

情况如下：

单位：万元

项 目	T2 年	T3 年	T4 年	T5 年	T6 年	T7 年
营业收入	54,600.00	124,800.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
减：营业成本	39,312.00	89,856.00	112,320.00	112,320.00	112,320.00	112,320.00
营业税金及附加	504.35	1,152.79	1,440.99	1,440.99	1,440.99	1,440.99
管理费用	4,368.00	9,984.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00
销售费用	1,365.00	3,120.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
利润总额	9,050.65	20,687.21	25,859.01	25,859.01	25,859.01	25,859.01
减：所得税	1,357.60	3,103.08	3,878.85	3,878.85	3,878.85	3,878.85
净利润	7,693.06	17,584.13	21,980.16	21,980.16	21,980.16	21,980.16

单位：万元

项 目	T8 年	T9 年	T10 年	T11 年	T12 年
营业收入	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
减：营业成本	112,320.00	112,320.00	112,320.00	112,320.00	112,320.00
营业税金及附加	1,440.99	1,440.99	1,440.99	1,440.99	1,440.99
管理费用	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00
销售费用	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
利润总额	25,859.01	25,859.01	25,859.01	25,859.01	25,859.01
减：所得税	3,878.85	3,878.85	3,878.85	3,878.85	3,878.85
净利润	21,980.16	21,980.16	21,980.16	21,980.16	21,980.16

注：T1 年为建设期第一年，T2 年上半年建设完成，下半年开始运营。

本次募投项目完全达产后预计年均实现销售收入 156,000.00 万元，年均实现净利润 21,980.16 万元，税后内含报酬率为 18.78%。

（一）营业收入

1、测算过程

本次募投项目的收入主要来源于新能源汽车用线路板和物联网用线路板的销售收入。

①销售数量测算

本次募投项目预计在 T2 年实现 31.5 万平方米的销售，T3 年实现 72 万平方米的销售，T4 年全部达产，以后每年实现 90 万平方米的销售。

②销售价格测算

本次募投项目的产品包括新能源汽车用线路板及物联网用线路板，根据该类产品当前的市场价格、市场竞争状况等，上述两类产品的均价预计分别为 1,600 元/平方米和 1,800 元/平方米，具体情况如下：

单位：万元

项 目	T2 年	T3 年	T4 年	T5 年	T6 年	T7 年
销售收入	54,600.00	124,800.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
达产比例	35%	80%	100%	100%	100%	100%
新能源汽车用线路板	16,800.00	38,400.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
价格（元/m ² ）	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
销量（万m ² ）	10.50	24.00	30.00	30.00	30.00	30.00
物联网用线路板	37,800.00	86,400.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
价格（元/m ² ）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
销量（万m ² ）	21.00	48.00	60.00	60.00	60.00	60.00

单位：万元

项 目	T8 年	T9 年	T10 年	T11 年	T12 年
销售收入	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
达产比例	100%	100%	100%	100%	100%
新能源汽车用线路板	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
价格（元/m ² ）	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
销量（万m ² ）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
物联网用线路板	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
价格（元/m ² ）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
销量（万m ² ）	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

注：T1 年为建设期第一年，T2 年上半年建设完成，下半年开始运营。

2、项目收入的合理性及测算谨慎性分析

（1）政策及市场双重利好，新能源汽车及物联网市场将迎来高速发展期

全球新能源汽车市场高速增长，2015年全球新能源汽车的产量超过60万辆，较2014年增长69%。目前，发展新能源汽车已经上升为国家战略，我国政府密集出台新能源汽车相关鼓励政策，涉及购买补贴、公务车更新、充电设施建设、车辆购置税等。在我国相关政策的支持下，国内新能源汽车产量连创新高。根据中

国汽车工业协会统计，2012年至2015年，我国新能源汽车产量保持200.46%的复合增长率快速增长，其中，2014年我国新能源汽车生产78,499辆，同比增长3.5倍；2015年我国新能源汽车生产340,471辆，同比增长3.3倍；2016年1-8月新能源汽车生产258,000辆，比上年同期增长1.11倍。

物联网方面，我国政府也相应出台鼓励政策，加快物联网、智能设备等行业的发展。根据Statista的数据，2015年我国智能家居市场规模达403.40亿元，同比增长41%，预计到2018年，我国智能家居市场规模将达到1,300亿元，年均复合增长率将达48%左右；根据IDC统计的数据，2015年可穿戴设备的全球出货量超过7,810万件，较2014年增长171.6%，预计到2019年，可穿戴设备的全球出货量将达到1.734亿件，年均复合增长率达到22%。

印制线路板是新能源汽车中电池模组、电控系统、汽车电子及物联网中的终端设备、服务器等的重要元器件，新能源汽车及物联网用 PCB 的市场需求将随着新能源汽车、物联网行业的快速增长而增长。

（2）公司市场竞争力不断提升，业务规模增长较快

2014 年、2015 年和 2016 年上半年，公司的营业收入分别为 108,672.54 万元、128,463.15 万元和 78,957.47 万元，2015 年、2016 年上半年的同比增长率分别为 18.12%和 38.33%，公司营业收入保持快速增长的趋势。本次募集资金用于新能源汽车及物联网用 PCB 项目，将有助于扩大公司的市场空间，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用。保守估计，若公司的营业收入每年保持 18.21%的增长率，公司到 2020 年的营业收入将达到 29.65 亿元，较 2015 年的营业收入增长 16.81 亿元。

综上，本项目营业收入的测算具有合理性、谨慎性。

（二）毛利率

1、测算过程

本次募投项目的营业成本主要包括材料消耗费、能耗（电力等）、人工工资及福利、制造费用等，预计毛利率为 28%。

2、项目营业成本的合理性及测算谨慎性分析

根据同行业可比上市公司 2015 年的财务数据，行业可比上市公司的平均毛利率为 21.59%，具体如下：

公司名称	2015 年毛利率
丹邦科技	37.31%
兴森科技	30.89%
依顿电子	24.31%
博敏电子	20.29%
超声电子	17.82%
中京电子	16.34%
超华科技	14.01%
沪电股份	11.72%
天津普林	-2.03%
行业平均毛利率*	21.59%
本项目达产后毛利率	28.00%
胜宏科技	24.37%

注：*天津普林 2015 年毛利润为-5,105.42 万元，严重亏损，其毛利率不具有参考意义；故在计算行业平均毛利率时没有将其纳入计算范围。

由上表可知，本次募投项目的毛利率预计为 28.00%，高于行业平均毛利率水平，主要原因系本项目产品新能源汽车用线路板、物联网用线路板均主要为多层高精密线路板，产品技术含量高，相对于现有市场产品具有较强的竞争力，毛利率相对较高。同时，公司 2016 年 1-6 月的毛利率为 27.32%。因此，该项目营业成本的测算具有合理性、谨慎性。

（三）营业税金及附加的测算

本次募投项目需缴纳的主要税种及税率包括：增值税 17%、城市维护建设税 7%、教育费附加 3%、地方教育费附加 2%等。

（四）销售费用的测算

1、测算过程

本次募投项目的销售费用主要包括人员工资、差旅费、市场推广费以及其他销售费用等，预计的销售费用率为 2.50%。

2、项目销售费用的合理性及测算谨慎性分析

根据同行业可比上市公司 2015 年的财务数据，同行业可比上市公司的平均销售费用率为 3.17%，具体如下：

公司名称	2015 年销售费用率
------	-------------

兴森科技	6.99%
沪电股份	4.46%
超华科技	3.31%
超声电子	2.98%
博敏电子	2.75%
中京电子	2.51%
丹邦科技	2.40%
天津普林	1.81%
依顿电子	1.32%
行业平均销售费用率	3.17%
胜宏科技	2.66%
本项目销售费用率	2.50%

由上表可知，同行业可比上市公司 2015 年的平均销售费用率为 3.17%，公司 2015 年的销售费用率为 2.66%。本次募投项目的产品为新能源汽车及物联网用线路板，公司现已生产、销售该类产品，该项目为公司现有业务的扩产，业务规模的扩大，有利于发挥规模效应，本次募投项目的销售费用率预计为 2.50%，略低于同行业可比上市公司的平均销售费用率及公司目前的销售费用率，具有合理性及谨慎性。

（五）管理费用的测算

1、测算过程

本次募投项目的管理费用主要包括人员工资、差旅费以及其他管理费用等，预计的管理费用率为 8.00%。

2、项目管理费用的合理性及测算谨慎性分析

根据同行业可比上市公司 2015 年的财务数据，同行业可比上市公司的平均管理费用率为 10.33%，具体如下：

公司名称	2015 年管理费用率
兴森科技	17.19%
丹邦科技	15.96%
中京电子	11.00%
超声电子	10.45%
博敏电子	9.56%
依顿电子	8.54%

天津普林	8.38%
沪电股份	6.29%
超华科技	5.59%
行业平均管理费用率	10.33%
胜宏科技	11.18%
本项目管理费用率	8.00%

本次募投项目的实施地点为上市公司目前主要生产经营所在地，且本次募投项目为公司现有业务的扩张。募投项目运营后，公司可以对现有生产经营与募投项目的生产经营进行协同管理，在管理上将会产生较为明显的规模效应，有助于降低募投项目的管理费用率。因此，本项目的管理费用率预计为 8.00%，低于同行业可比上市公司的平均水平及公司现有水平，具有合理性及谨慎性。

二、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了本次非公开发行 A 股股票预案、募投项目的可行性研究报告、与本次非公开项目相关会议的决议文件、同行业可比上市公司的资料、相关行业报告等资料，并访谈了发行人高管，了解本次募投项目效益测算的依据，分析其合理性。

经核查，保荐机构认为：

本次募投项目相关参数的选取和效益的测算合理、谨慎。

问题（5）说明本次募投项目产品与公司现有产品、首发募投项目高端精密线路板扩产项目产品的异同，包括但不限于产品用途、生产工艺、技术、原材料、客户等。

一、本次募投项目产品与公司现有产品、首发募投项目高端精密线路板扩产项目产品的异同

本次募投项目为新能源汽车及物联网用线路板项目，是公司根据市场需求、行业发展方向及公司未来发展战略的考虑，在现有产品的基础上，扩大应用于新能源汽车和物联网设备产品的生产规模，优化产品结构，提高公司的市场竞争力，提升盈利能力。

本次募投项目产品与公司现有产品、首发募投项目高端精密线路板扩产项目的产品主要为多层高精密印制线路板，公司现有产品及首发募投项目产品主要应用于显卡等计算机周边、消费电子、LED、工业控制、汽车电子用线路板，而应

用于动力电池、电控系统、充电桩等新能源汽车用及智能家居、服务器等物联网用线路板占比较低，与本次募投项目产品的用途、客户存在部分相同的情况；运用的生产工艺、核心生产技术差异较小，差异主要体现在各类产品具体的生产工艺技术指标以及运用的针对具体产品的生产技术；主要原材料的种类基本相同，但各类产品对具体原材料的具体参数、性能存在差异。

本次募投项目的产品包括新能源汽车用线路板、物联网用线路板两大类，在产品用途、生产工艺、核心技术、产品相关专利、原材料及主要客户等方面，与公司现有产品、首发募投项目产品的主要异同具体如下：

项目	本次募投项目	公司现有产品	首发募投项目
主要产品	多层高精密印制线路板	多层高精密印制线路板	多层高精密印制线路板
产品用途	主要用于新能源汽车的动力电池、充电桩、电控系统、汽车电子、物联网终端设备、服务器等	主要用于计算机及周边、消费电子、LED等	主要用于汽车电子、大型网络交换系统服务器、工业控制、LED等
生产工艺	包括传统 PCB 生产流程，还用到铜基板加工工艺及厚铜防焊、压合填胶等工艺	主要是传统 PCB 制作流程	包括传统 PCB 生产流程，还用到通盲孔电镀、小间距线路及细孔径工艺等
核心技术	除常用的 PCB 生产的核心技术外，还包括压合特殊生产技术、成型及线路对位精确度生产技术等	常用的 PCB 生产的核心技术	除常用的 PCB 生产的核心技术外，还包括多次叠加层次有微小孔设计技术、窄线路及细孔径生产技术等
产品相关专利	1.一种厚铜板防焊工艺，中国发明专利，专利号 ZL201210346989.2 2.一种线路板压合填胶的方法，中国发明专利，专利号 ZL201210529639.X 3.一种混合材料印制线路板新型制作方法，中国发明专利，专利号 ZL201510693313.4 4.一种 PCB 厚铜板油墨印刷方法，中国发明专利，专利号 ZL201210578392.0 5.一种多层阶梯印制插头线路板制作工艺，中国发明专利，专利号	1.一种多层线路板层间和钻孔偏移检测方法，中国发明专利，专利号 ZL201010596657.0 2.一种 PCB 半金属化孔成型方法，中国发明专利，专利号 ZL201210221334.2 3.一种曝光底片防焊手动对位图形设计方法，中国发明专利，专利号 ZL201210558885.8 4.一种红胶片通孔的加工方法，中国发明	1.一种在 HDI 线路板上埋塞孔的方法，中国发明专利，专利号 ZL201110437166.6 2.一种防层偏的多层线路板生产方法，中国发明专利，专利号 ZL201310114656.1 3.一种测试 HDI 线路板盲孔品质的方法，中国发明专利，专利号：ZL201310163034.8 4.一种多镀层线路板及其生产方法，中国发明专利，专利号 ZL201310524466.7

	201510734931.9 6.一种动力电池线路板的内层铜露铜制作方法,中国发明专利,专利号 ZL201610193660.5 7.一种厚铜线路板铜面加厚方法,中国发明专利,专利号 ZL201310148136.2 8.一种 PCB 分段金手指制备方法,中国发明专利,专利号 ZL201310148080.0 9.一种薄板后期制作工艺,中国发明专利,专利号 ZL201210347017.5	专利,专利号: ZL201310453324.6 5.一种无定位孔的线路板成型方法,中国发明专利,专利号 ZL201510736517.1 6.一种 PCB 板翘曲矫正方法,中国发明专利,专利号 201610358842.3	5.一种防止光学定位点脱落方法,中国发明专利,专利号: 201410249276.3 6.一种线路板盲孔深度测试结构及其测试方法,中国发明专利,专利号 ZL201510429804.8 7.一种 HDI 通盲孔电镀方法,中国发明专利,专利号 201610358841.9 8.一种多层 LED 混合材料线路板的层压方法,中国发明专利,专利号 ZL201210356417.2
核心技术鉴定情况	1.以“高端高频材料线路板制作技术”,在中国印制电路行业协会鉴定为国内先进技术,鉴定编号为 CPCA 科技委评字:[2015]第 003 号,获得惠州市科学技术局科技成果登记,登记号为惠科登字[2015]8 号,技术产品“高端高频线路板”获得“广东省高新技术产品”证书编号粤高企协[2014]53 号 2.以“多层印制阶梯插头线路板制作技术”在中国印制电路行业协会鉴定为国内先进技术,鉴定编号为 CPCA 科技委评字:[2015]第 004 号 3.以“高端分段插头板工艺技术”在中国印制电路行业协会鉴定为国内先进技术,鉴定编号为 CPCA 科技委评字:[2015]第 005 号,获得惠州市科学技术局科技成果登记,登记号为惠科登字[2015]9 号	1.以“运用于 PCB 制造过程中的核心技术”在中国印制电路行业协会鉴定为国内领先技术,鉴定编号为 CPCA 科技委评字:[2012]第 002 号,获得惠州市科学技术局科技成果登记,登记号为惠科登字[2012]49 号,并获得惠州市科学技术奖二等奖,证书编号 2013-J2-02-D01 2.产品“高精密显卡板”获得“广东省高新技术产品”证书编号粤科高字[2013]40 号	1.以“HDI 跨层盲孔制作技术”在中国印制电路行业协会鉴定为国内先进技术,鉴定编号为 CPCA 科技委评字:[2015]第 001 号,获得惠州市科学技术局科技成果登记,登记号为惠科登字[2015]7 号 2.以“高端四阶 HDI 板制作技术”在中国印制电路行业协会鉴定为国内先进技术,鉴定编号为 CPCA 科技委评字:[2015]第 002 号 3.产品“高端通讯背板”获得“广东省高新技术产品”证书编号粤科高字[2014]54 号 4.产品“高密度互连印制电路板”获得“广东省高新技术产品”证书编号粤高企协[2016]1 号 5.产品“高端汽车板”获得“广东省高新技术产品”证书编号粤科高字[2014]54 号
原材料	包括覆铜板、半固化片、铜箔、油墨等 PCB 常用原材	覆铜板、半固化片、铜箔、油墨等普通材	覆铜板、半固化片、铜箔、油墨等普通材料

	料,以及该类产品用的覆盖膜、纯胶及补强膜等	料	
主要客户	沃特玛、亿能电子、乐视、飞毛腿、德赛西威、武汉凡谷、清华同方等	富士康、戴尔、海康威视、纬创、台达等	华硕、利亚德、乐视、兆光光电、德赛西威、技嘉、沃特玛等

二、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了本次非公开发行 A 股股票预案、募投项目的可行性研究报告、招股说明书、2015 年年度报告及 2016 年 1-6 月财务报告、与本次非公开项目相关会议的决议文件等,并访谈了发行人高管,了解本次募投项目与公司现有产品、首发募投项目产品的异同。

经核查,保荐机构认为:

本次募投项目产品与公司现有产品、首发募投项目高端精密线路板扩产项目的产品主要为多层高精密印制线路板,产品的用途、客户存在部分相同的情况;运用的主要生产工艺、核心生产技术差异较小;主要原材料的种类基本相同,但各类产品对具体原材料的具体参数、性能存在差异。

2、根据本次非公开发行预案,申请人拟使用募集资金 111,198.68 万元投入“新能源汽车及物联网用线路板项目”。申请人前次募集资金投资项目“高端高精密线路板扩产项目”仍处于建设期,尚未达到预定可使用状态。

请申请人:(1)在本次非公开发行预案中补充披露募投项目的实施主体,资金投入方式,募投项目用地的取得方式及相关用地手续的办理进展情况;(2)补充披露本次募投项目与公司现有业务之间的关系,是否涉及新产品研发,结合募投项目在具体产品、下游客户、业务模式、核心技术等方面与前次募投项目之间的关系,说明本次募集资金的必要性。请保荐机构、申请人律师核查上述问题并发表明确意见。

【回复】

问题(1)在本次非公开发行预案中补充披露募投项目的实施主体,资金投入方式,募投项目用地的取得方式及相关用地手续的办理进展情况;

一、募投项目的实施主体、资金投入方式

本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司自身,由上市公司直接投资实施该项目,实施地点为广东省惠州市淡水镇新桥村行诚科技园。

二、募投项目用地的取得方式及相关用地手续的办理进展情况

募投项目用地为发行人目前生产经营所在地，地址为广东省惠州市淡水镇新桥村行诚科技园，该土地通过受让取得。

发行人已办理了相关用地手续，并取得了惠州市人民政府出具的惠阳国用（2012）第 0101537 号国有土地使用证，使用权面积为 217,480 平方米，终止日期为 2054 年 8 月 19 日。此外，该项目取得了地字第 441303201210375 号建设用地规划许可证，用地性质为工业用地。

三、保荐机构及发行人律师核查意见

保荐机构偕同发行人律师查阅了本次非公开发行 A 股股票预案、募投项目的可行性研究报告、土地使用权证书、与本次非公开项目相关会议的决议文件等，并访谈了发行人高管，了解本次募投项目的实施主体、资金投入方式及用地情况。

经核查，保荐机构认为：

募投项目的实施主体为上市公司自身，由上市公司直接投资实施该项目，募投项目用地已取得土地使用权证书及建设用地规划许可证。

经核查，发行人律师认为：

本次募集资金投资项目均由发行人自行实施，不涉及与他人进行合作的情形，发行人募投项目用地的取得方式及相关用地手续真实、合法、有效。

四、补充披露情况

募投项目的实施主体及资金投入方式、募投项目用地的取得方式及相关用地手续的办理进展情况已分别在《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析”之“（一）项目基本情况”、“（四）项目备案及相关手续进展情况”中补充披露。

问题（2）补充披露本次募投项目与公司现有业务之间的关系，是否涉及新产品研发，结合募投项目在具体产品、下游客户、业务模式、核心技术等方面与前次募投项目之间的关系，说明本次募集资金的必要性。

一、本次募投项目与公司现有业务之间的关系，是否涉及新产品研发

（一）本次募投项目与公司现有业务之间的关系

公司主要从事印制线路板的研发、生产及销售，主要产品应用于计算机及周边、消费电子、工业控制、汽车、LED等领域，少量产品应用于新能源汽车和物联网等领域。

本次募投项目为新能源汽车及物联网用线路板项目，在现有产品的基础上，扩大应用于新能源汽车和物联网设备产品的生产规模，进一步优化产品结构，提升盈利能力。

（二）是否涉及新产品研发

公司已具备生产应用于新能源汽车和物联网设备产品的印制线路板的生产工艺和主要核心技术，公司目前的技术水平已能基本满足本次募投项目产品的生产。但由于印制线路板属于定制产品，不同客户对产品的具体要求存在差异，公司将会根据客户对产品的具体要求，在自身具备该产品生产能力的基础上，进行研究、开发，因此，本次募投项目会存在少量生产工艺及核心技术的研发，以实现新产品的生产。

二、结合募投项目在具体产品、下游客户、业务模式、核心技术等方面与前次募投项目之间的关系，说明本次募集资金的必要性

（一）前次募投项目的基本情况

公司前次募投项目为高端高精密线路板扩产项目和研发中心建设项目，总投资75,931万元，其中募集资金投入53,327万元。截至2016年7月31日，公司已使用募集资金42,959.12万元，占募集资金净额的80.56%。

其中，高端高精密线路板扩产项目主要生产高端HDI板、高端汽车板、高端光电板、高端通讯背板等印制线路板，投资总额为72,814万元，拟投入募集资金50,209.91万元。截至2016年7月31日，该项目已按计划投入41,007.65万元，占拟投入募集资金金额的81.67%，投资计划尚无变化。该项目已实现部分产能，2016年1-7月实现的效益为3,449.61万元，效益实现情况良好。

（二）本次募投项目与前次募投项目之间的关系

本次募投项目是发行人现有业务及前次募投项目产品的延伸，与前次募投项目之间的具体对比如下：

	本次募投项目	前次募投项目
项目名称	新能源汽车及物联网用线路板项目	高端高精密线路板扩产项目
总投资	111,198.68 万元	72,814 万元
具体产品	多层高精密印制线路板	多层高精密印制线路板
产品用途	主要用于新能源汽车的动力电池、充电桩、电控系统、汽车电子、物联网终端设备、服务器等	主要用于汽车电子、大型网络交换系统服务器、LED 等

下游客户	沃特玛、亿能电子、乐视、飞毛腿、德赛西威、武汉凡谷、清华同方等	华硕、利亚德、乐视、兆光光电、德赛西威、技嘉、沃特玛等
业务模式	根据客户订单需求及预测进行原材料的采购，并进行产品生产及销售	根据客户订单需求及预测进行原材料的采购，并进行产品生产及销售
核心技术	除常用的 PCB 生产的核心技术外，还包括压合特殊生产技术、成型及线路对位精确度生产技术等	除常用的 PCB 生产的核心技术外，还包括多次叠加层次有微小孔设计技术、窄线路及细孔径生产技术

(三) 本次募集资金的必要性

1、新能源汽车及物联网行业发展快速，快速抢占市场的需要

(1) 根据IEA（国际能源署）预计，至2020年，全球新能源汽车总销量将接近600万辆，全球新能源汽车保有量目前将达到2000万辆。2015年中国新能源汽车销量33.11万辆，同比增长3.43倍，据中国汽车工业协会预计，到2020年我国新能源汽车销量规模将突破200万辆。

(2) 物联网在实际生活中有智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能穿戴和智能家居等 10 大应用领域。高端高阶高精密线路板在物联网中的应用，主要集中在智能家居、智能可穿戴设备、车联网等领域。

①智能家居通过物联网技术将家庭中的各种设备（如音视频设备、照明系统、空调控制、安防系统等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、防盗报警、环境监测以及可编程定时控制等多种功能和手段。根据 Statista 的数据，2015 年我国智能家居市场规模达 403.40 亿元，同比增长 41%。预计到 2018 年，我国智能家居市场规模将达到 1,300 亿元，未来年均复合增长率将达 48%左右。

②随着移动智能终端的普及和移动互联网的发展，在运动健康追踪设备和 Apple Watch 日益流行的推动下，全球可穿戴设备市场大幅增长。根据 IDC 统计的数据，2015 年可穿戴设备的全球出货量超过 7,810 万件，较 2014 年增长 171.6%，预计到 2019 年，可穿戴设备的全球出货量将达到 1.734 亿件，年均复合增长率达到 22%。

③国家高度重视车联网应用，工业和信息化部在《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中首次提出要出台《车联网发展创新行动计划（2015-2020 年）》，推动车联网技术研发、标准制定，组织开展车联网试点、基于 5G 技术的车联网示范。随着车联网应用场景不断拓展，未来车联网市场空间大，预计 2017 年车联网市场规模将达 2,640 亿元。

公司生产的多层板和HDI板等产品广泛用于新能源汽车和物联网设备领域。随着新能源汽车的普及和发展，以及物联网设备的高速发展，印制线路板将迎来广阔的市场发展空间。为适应市场的快速发展趋势，公司必须保持适度超前的产能规划，以满足下游市场的发展需求。

2、公司新能源汽车及物联网用产品销售收入快速增长，产能已接近饱和，公司扩大生产规模的需要

公司已通过汽车行业ISO/TS16949：2009质量管理体系认证，并已开始生产、销售新能源汽车及物联网用线路板，主要客户包括沃特玛、乐视、飞毛腿、德赛西威等，且销售收入快速增长。2013年、2014年、2015年，公司的产能利用率及产销率接近100%，具体情况如下：

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
产能利用率（%）	103.99	105.62	101.01
产销率（%）	99.11	96.90	101.03

由上表可知，公司的产能利用处于满负荷状态，为满足市场需求，提高公司市场竞争力，必须新增生产线，扩大生产规模。

3、公司实现业务可持续发展的需要

随着近年来公司的快速发展，公司产能已达饱和，且公司的产品品质及市场竞争力不断提高，产品的市场需求旺盛，现有产能难以满足客户的需求。同时，公司一直以来注重核心技术的研发，不断提高产品质量，目前已具备开发、生产新能源汽车及物联网用线路板的核心技术和专业人才。

在现有产能已达饱和及新能源汽车及物联网用线路板的相关核心技术已掌握的基础上，公司需扩大产能，优化产品结构，以满足不断增长的订单需求，进一步扩大市场份额，实现公司的可持续发展。

4、涉足新能源汽车及物联网领域，有助于实现公司战略目标

公司作为国内印制线路板行业主要的生产企业之一，致力于成为国内领先的印制线路板供应商。近年来，公司不断提高生产能力和研发能力，进行产品和技术创新，提高管理水平，市场竞争力不断提高。新能源汽车及物联网用线路板具有广阔的市场前景，同时，公司已掌握了生产上述产品的核心技术及专业人才。公司实施本次募投项目，顺应国家发展的战略，抢占行业内技术及产品的制高点，将继续巩固公司在印制线路板产品行业的优势地位，提升市场竞争力。因此，快

速进入新能源汽车及物联网领域，抢占市场，同时扩大企业的生产能力，增强规模效益，有助于实现公司的发展战略。

三、保荐机构及发行人律师核查意见

保荐机构偕同发行人律师查阅了本次非公开发行A股股票预案、募投项目的可行性研究报告、与本次非公开项目相关会议决议文件、招股说明书、行业研究报告等资料，并访谈了发行人高管，了解本次募投与前次募投的关系、公司未来发展战略及行业发展情况，分析本次募集资金的必要性。

经核查，保荐机构认为：

本次募投项目符合行业未来发展趋势，有利于公司扩大产能，优化产品结构，提高公司的市场竞争力，本次募集资金是必要的。

经核查，发行人律师认为：

本次募投项目实施后，发行人的产品结构将得到优化，并进一步巩固发行人的市场竞争地位，实现发行人的发展战略，本次募集资金是必要的。

四、补充披露情况

本次募投项目与公司现有业务之间的关系、本次募集资金的必要性已在《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报所采取的措施”之“（二）本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况”中补充披露。

二、一般问题

1、本次非公开发行预案关于全球 PCB 总产值及增长率，中国 PCB 总产值及增长率所引用的数据为 2015 年一季度数据，请申请人对相关数据进行更新，请保荐机构对相关数据来源的客观性，及时性发表意见。

【回复】

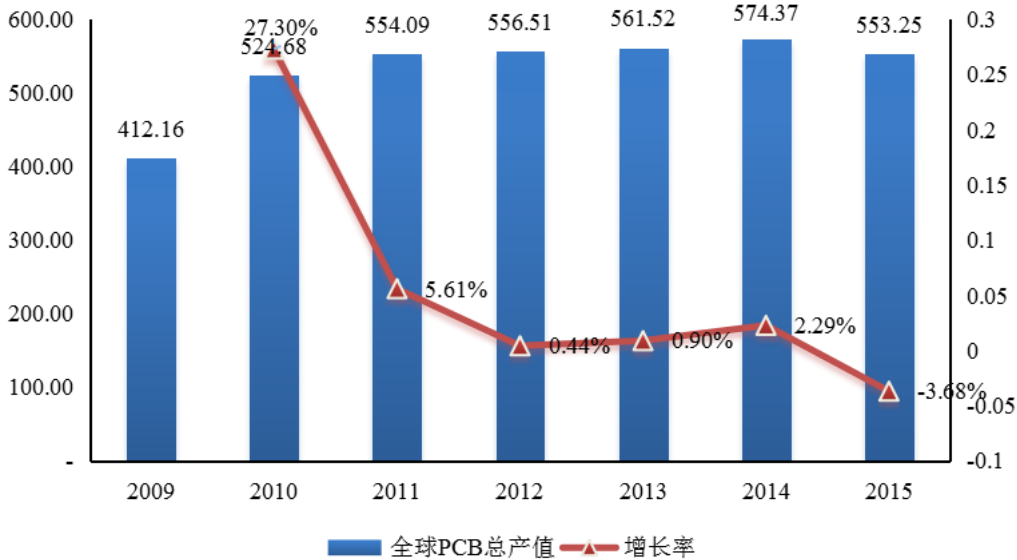
一、请申请人对相关数据进行更新

（一）全球 PCB 产值保持稳定，未来仍有增长空间

近年来，全球 PCB 行业总体呈稳步增长态势。据 Prismark 统计，2009 年至 2015 年，全球 PCB 产值保持 5.02%的年复合增长率稳定增长，其中，2014 年全

球 PCB 产值达到 574.37 亿美元,同比增长 2.29%,2015 年全球 PCB 产值为 553.25 亿美元,同比下降 3.68%。据 Prismark 预计,2015 年~2020 年全球 PCB 产值复合年均增长率为 2.0%。2009 年—2015 年全球 PCB 行业总产值情况如下:

单位: 亿美元



数据来源: Prismark

（二）中国 PCB 行业保持稳定增长态势

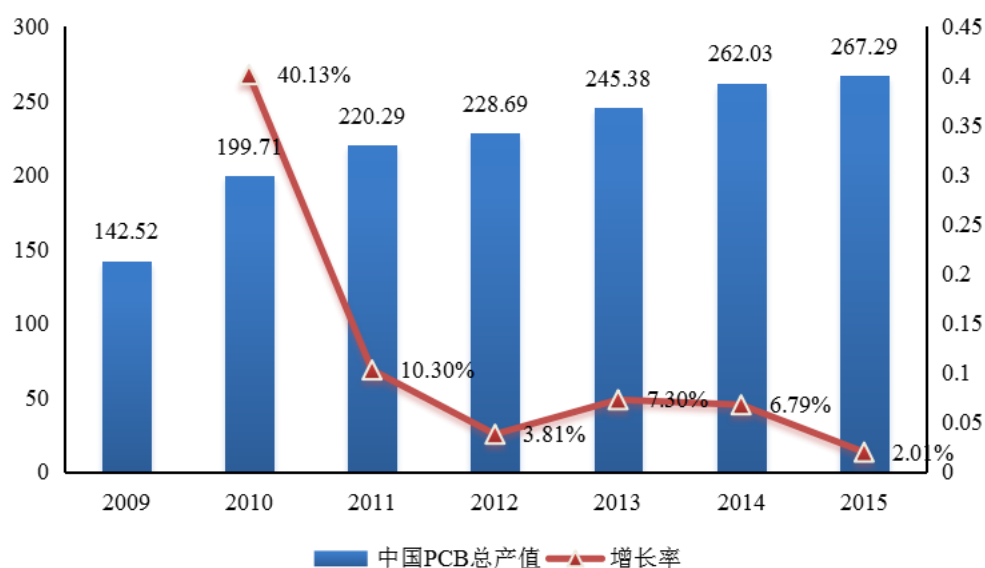
据 Prismark 统计,从 2006 年开始,中国超过日本成为全球产值最大、增长最快的 PCB 制造基地,并已成为推动全球 PCB 行业发展的主要增长动力。

2008 年全球金融危机之后,2010 年中国的 PCB 产业全面复苏,同比上涨 40.13%,达 199.71 亿美元。

2011 年—2012 年,随着全球电子产业和 PCB 行业进入调整期,中国 PCB 的增长也有所放缓,全国 PCB 行业总产值分别为 220.29 亿美元、228.69 亿美元,增长率分别为 10.30%、3.81%。

2013 年—2015 年,全国 PCB 行业总产值有所恢复,总产值分别为 245.38 亿美元、262.03 亿美元和 267.29 亿美元,同比增长率分别为 7.30%、6.79%和 2.01%。据 Prismark 预计,2015 年~2020 年中国 PCB 产值复合年均增长率为 3.1%。2009 年—2015 年中国 PCB 产值变化情况如下:

单位: 亿美元



数据来源：Prismark

申请人已在本次非公开发行预案中更新上述行业数据。

二、请保荐机构对相关数据来源的客观性，及时性发表意见

保荐机构查阅了 Prismark 的研究报告，Prismark 成立于 1994 年，是印制线路板及其相关领域知名的市场分析机构，以及 CPCA（中国印制电路行业协会）2016 年 8 月发布的《2015 年中国印制电路行业发展状况报告》，了解全球及中国印制线路板行业的发展情况行业数据来源。

经核查，保荐机构认为：

本次非公开发行预案关于全球及中国 PCB 总产值及增长率数据已更新，相关数据来源客观、及时。

（本页无正文，为胜宏科技（惠州）股份有限公司《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》之盖章页）

胜宏科技（惠州）股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为国信证券股份有限公司《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》之签字盖章页）

保荐代表人：

郭振国

郑 琨

内核负责人:

曾 信

保荐业务负责人:

胡华勇

国信证券股份有限公司

年 月 日